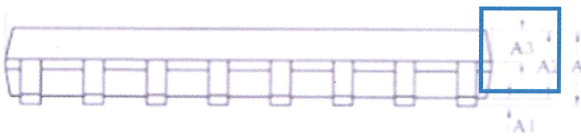
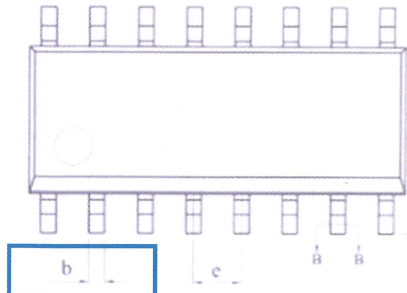


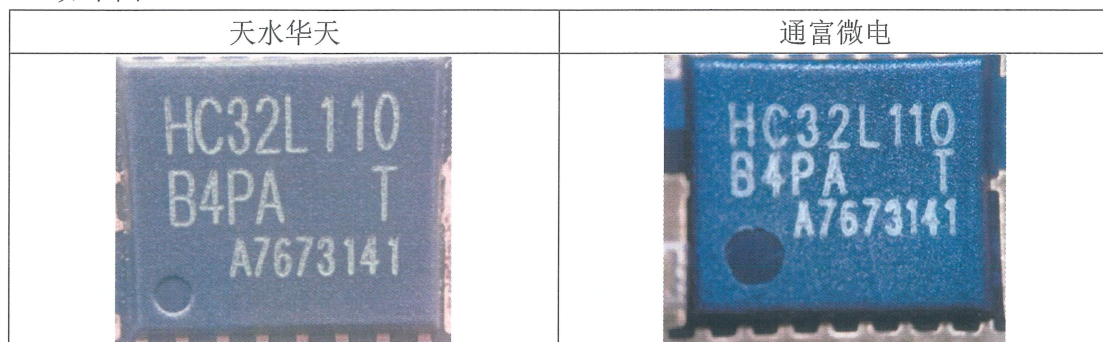
HC32L110B4PA-TSSOP16 产能扩充的通知

客户名称	ALL	联系人	NA
------	-----	-----	----

受影响产品	商业名称	物料编码
	HC32L110B4PA-TSSOP16	2L110B40-0053C0TS1B

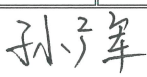
变更原因描述	为应对 2021 年封装测试产能紧张，为保障对客户的供货，产能扩充第二供应商。		
变更方法描述	1. 供应商扩充		
	封装类型	现有供应商	扩充后
	TSSOP16	天水华天科技股份有限公司	天水华天科技股份有限公司及通富微电子股份有限公司
	2. 扩充的第二家供应商为国内排名前三的供应商，且华大均有相同封装类型的其他产品导入量产。		
	3. 扩充至第二家供应商后，封装芯片外形尺寸除上胶体厚度 A3 和引脚宽度 b 尺寸有差异外，其他尺寸相同，芯片的功能及性能无影响。		
	 		
	POD 尺寸	天水华天	通富微电
	A3	0.44±0.05mm	0.44±0.10mm
	b	0.245±0.045mm	0.24±0.04mm

4. 扩充至第二家供应商后，芯片表面的 **Pin1 孔变大**，丝印字体缩小，不影响芯片的使用。如下图：



5. 包装和产品标识没有变化。
6. 变更验证计划：
变更验证计划完成时间 2021/5/12，样品准备完成时间 2021/5/12。
7. 变更前在途、在库产品
变更验证通过前涉及物料保持原供应商继续生产，销售接单不受影响。

变更生效日期或产品 Date Code 说明：扩产通富微电的变更计划于 **2021/5/12** 生效

发行人	康超	发行日期	2021/3/25
华大半导体 MCU 事业部工程部经理签署：			
		日期：2021.3.25	



客户	部确认意见：
签署：	日期：

✧ 以上，特此通知，如果您有任何意见或建议，请随时与我司销售部门联系。✧